

113 年度智慧財產權切結書

公佈時間：112 年 10 月 02 日

立書人_____ (請以教師為立書人), 茲就委託台灣半導體研究中心製作之晶片 / PCB 內容保證如下：

- 一、立書人保證其委託內容絕無任何違反專利權、著作權法、或其他智慧財產權之相關規定，若有涉及侵害他人專利權、著作權法、或其他智慧財產權之情事，立書人願負一切法律之責任並解決之。
- 二、本切結書內容，如有虛偽不實之情事，致使台灣半導體研究中心遭受損害，立書人願負完全責任。
- 三、本切結書適用於自簽署日起至至 113 年 12 月 31 日期間，立書人所申請之晶片製作申請案件。

此致

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心

立書人：

服務機關：_____ (請蓋系所科章)

姓 名：_____ (簽章)

地 址：_____

聯絡電話：_____

傳真號碼：_____

E - mail：_____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日